アモルファス酸化物薄膜のトランスバース型フレキシブル熱電変換素子

Amorphous Oxide Thin-Film for Transverse-type Flexible Thermoelectric-Generator

1. 奈良先端大 ⁰梅田鉄馬¹, 上沼睦典¹瀬名波大貴¹, Jenichi Felizco¹, 石河泰明¹,

浦岡行治¹,足立秀明¹

1. NAIST °Kenta Umeda¹, Mutsunori Uenuma¹, Daiki Senaha¹, Jenichi Felizco¹, Yasuaki Ishikawa¹,

Yukiharu Uraoka¹ and Hideaki Adachi¹

E-mail:umeda.kenta.ua9@ms.naist.jp

背景

アモルファス InGaZnO(IGZO)はディスプレイの駆動素子として注目を浴びている n 型酸化物半導体である。IGZO はバンドギャップが広く、可視光において透明で低温プロセスで作製が可能である ことから、フレキシブルな基板上への形成にも適している。さらに酸化物半導体は作製プロセスが すでに確立しており、回路の集積や積層が容易である。また IGZO は比較的大きなゼーベック係数を 持つことが知られているので、熱電変換素子へ適用することで、透明でフレキシブルな熱発電デバ イスの実現が期待される。熱電変換素子(Thermoelectric Generator,TEG)は一般に n 型材料と p 型材料 を直列に繋いで縦方向に伝熱させる n 型構造で構成される場合が多いが、本研究では薄膜熱電材料 を用いて素子の作製を行うため、面内に横方向の伝熱を実現して高い電力密度を確保することがで きるトランスバース型という構造を採用した[1]。

これまでに我々はガラス基板上に IGZO/ITO の熱電変換素子を実現してきた[2,3]。 今回はフレキシ ブルな基板である Polyethylene-naphthalate(PEN)基板上を用いて, IGZO/Mo を 625 個直列に接続した トランスバース型 IGZO/Mo-TEG を作製しその特性評価を行った。

実験方法

n型熱電薄膜として, IGZO(1:1:1:4)薄膜を RF マグネトロンスパッタリング法により PEN 基板上に 室温下で Ar = 20 sccm, 成膜圧力 0.6 Pa, RF 電力 100 W で 200 nm 成膜した。また今回は p 型酸化 物薄膜の代わりに Mo(100 nm)電極膜を電子ビーム蒸着法で堆積して用いた。ヒートガイドとしてス ピンコート法を用いて KMPR1035 を膜厚 100 µm 塗布し,フォトリソグラフィでパターニングを行 った。作製した TEG の断面図を Fig1 に示す。TEG のサイズは 3 cm×1 cm の PEN 基板上に 625 個の Mo(850 µm×200 µm) / IGZO(500 µm×200 µm)セルが直列に接続されている。

結果と考察

素子外観を Fig2.に、また上部から光学顕微鏡でみた図を Fig3.に示す。これらから設計通りにメタ ルマスクを用いて TEG のパターニングが形成できていることがわかる。TEG の 1/3 を触れた際、室 温と体温の温度差で 19.2 mV の起電力を得ることができた。 上記の成膜条件で成膜した際の IGZO のゼーベック係数は 100 µV/K であるため、200 個のセルが機能していることを考慮した場合、セル 間に約 1 ℃の温度差ができていることが確認でき、ヒートガイドが設計通り働いていることがわか った。以上のように今回フレキシブル PEN 基板上の IGZO を用いてトランスバース型 TEG の実現に 成功した。今後、成膜時の条件や TEG 構造およびセル数を最適化することで特性の改善が見込める。 さらに、電極を Mo から ITO に変えることで透明でフレキシブルな TEG の実現が可能になる。



参考文献

[1] N.Chiwaki *et al.*, 64th JSAP spring, 15p-E206-3, (2017)

- [2] M. Uenuma, J. C. Felizco, D. Senaha and Y. Uraoka, 17th PowerMEMS2017
- [3] K. Umeda, M. Uenuma, D. Senaha, J. C. Felizco, Y. Uraoka, and, H. Adachi, 17th PowerMEMS2017